

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-11-086

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于子公司上海新昇半导体科技有限公司获得政府补助的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下称道“本公司”）于11月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于子公司上海新昇半导体科技有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2015-11-085），上海新昇获得中央财政补贴和地方财政补贴共计74,875万元，分三年拨付，其中2015年获得33,081.37万元。

现对相关事项补充说明如下：

一、关于持股比例

上海新昇半导体科技有限公司为本公司的参股子公司，持股比例为32%。上海新昇股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例%
1	上海新阳半导体材料股份有限公司	19000	38.00%
2	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	16000	32.00%
3	上海皓芯投资管理有限公司	10000	20.00%
4	上海新傲科技股份有限公司	5000	10.00%
合计		50000	100.00%

二、关于补助款项拨付进度

根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2015年立项课题经费支出预算核定表，本项目补助款项按照项目预算分三年拨付，具体进度如下：

单位：万元

资金来源	2015年度	2016年度	2017年度	合计
------	--------	--------	--------	----

中央财政支持	32311.00	8215.00	12.00	40538.00
地方财政支持	770.37	30500.12	3066.51	34337.00
企业自筹	5240.29	6929.21	34367.50	46537.00
合计	38321.66	45644.33	37446.01	121412.00

三、财务核算方式及对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上海新昇于收到上述补助款项时计入递延收益，后期陆续收到的政府补贴均按此处理。上述补助款项专门用于300mm半导体硅片的技术研发，上海新昇将会根据款项的使用进度，同时确认研发费用和营业外收入，对上海新昇财务报表当期净利润不会产生重大影响。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。

上海新昇为本公司的参股子公司，不纳入本公司的合并报表范围，对上海新昇的投资作为长期股权投资，采取权益法核算，即上海新昇的当期损益的32%计入本公司的投资收益。本次上海新昇获得政府补助不会对本公司财务报表产生重大影响。

四、其他风险提示

上海新昇300毫米半导体硅片项目存在的主要风险为：

（1）技术开发风险

300毫米硅片技术是由一整套工艺、设备、制造、检测、辅助技术组成的技术池，一些关键性技术和Know-how的缺乏，可能导致技术开发风险。

（2）质量管控风险

300毫米硅片的主要应用在于深亚微米级极大规模集成电路，对硅片的精细化程度和质量精度要求极高，产品生产过程的管控不利可能导致质量管控风险。

（3）市场开发风险

300毫米硅片市场目前主要控制在世界前五大硅片供应商手里，主要市场开发风险是与这些现有供应商的竞争。

（4）环保与安全风险

本项目属硅片行业，生产过程会产生一定量的硅片切削清洗废水、酸性废气等少量的三废，使用一定危险气体，存在环保与安全风险。

截止本公告日，上海新昇尚未收到补助款项，上海新昇定位于300毫米硅片的生产与销售，能否顺利实现300毫米半导体硅片的产业化尚存在一定程度的不确定性，同时由于本项目投资数额较大，需要经过建设期和市场推广期，预计短期之内难以产生经济效益，在此期间将会对本公司的经营业绩产生一定影响。公司将根据项目实际进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2015年11月25日